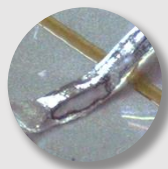


製品一覧

業界初！

非接触・非破壊・瞬時測定を初実用化



■ Laser Bond Tester I d

<手動測定>

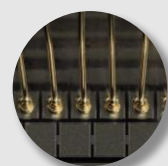
アルミ太径レーザーボンドテスター
(測定対象: $\phi 50\mu\text{m} \sim \phi 200\mu\text{m}$
 $\phi 200\mu\text{m} \sim \phi 400\mu\text{m}$)



■ Laser Bond Tester I

<自動測定>

アルミ太径レーザーボンドテスター
(測定対象: $\phi 50\mu\text{m} \sim \phi 200\mu\text{m}$
 $\phi 200\mu\text{m} \sim \phi 400\mu\text{m}$)



■ Laser Bond Tester II d

<手動測定>

金/銅細径レーザーボンドテスター
(測定対象: $\phi 15\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$)



■ Laser Bond Tester II

<自動測定>

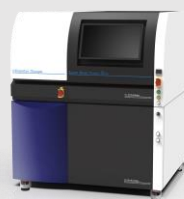
金/銅細径レーザーボンドテスター
(測定対象: $\phi 15\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$)



■ Laser Bond Tester I・II + Magazine Changer

<全自動測定>

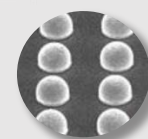
- 金/銅細径レーザーボンドテスター
(測定対象: $\phi 15\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$)
- アルミ太径レーザーボンドテスター
(測定対象: $\phi 50\mu\text{m} \sim \phi 200\mu\text{m}$ 、 $\phi 200\mu\text{m} \sim \phi 400\mu\text{m}$)



■ Laser Bump Tester

<手動または自動測定>

ウエハ金バンプテスター
(測定対象: $\phi 10\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$)



検査対象部位	アルミワイヤボンズの接合面積		金/銅ワイヤボンズの接合面積	金ウエハバンプの接合面積
検査対象	パワー半導体、IGBTなど		メモリIC、ロジックIC、 光半導体など	ウエハレベルCSP
ワイヤ径・バンプ径	$\phi 50\mu\text{m} \sim \phi 200\mu\text{m}$ (細径)	$\phi 200\mu\text{m} \sim \phi 400\mu\text{m}$ (太径)	$\phi 15\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$ (極細径)	$\phi 10\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$ (WLCSP)
レーザータイプ	赤外半導体レーザー		青色半導体レーザー	
レーザースポット	$\phi 50\mu\text{m}$	$\phi 200\mu\text{m}$	$\phi 20\mu\text{m}$	$\phi 10\mu\text{m}$
手動評価装置 (電動ステージ)	Laser Bond Tester I d -SD50M	Laser Bond Tester I d -LD200M	Laser Bond Tester II d -ESD20M	Laser Bump Tester -WB10M
半自動検査装置 (画像位置補正)	Laser Bond Tester I -SD50SA	Laser Bond Tester I -LD200SA	Laser Bond Tester II -ESD20SA	Laser Bump Tester -WB10SA
全自動検査装置 (マガジン供給)	Laser Bond Tester I -SD50A	Laser Bond Tester I -LD200A	Laser Bond Tester II -ESD20A	Laser Bump Tester -WB10A
インライン検査装置	開発中	開発中	開発中	開発中

2023年1月現在

標準納期：仕様詳細ご承認後6か月～

1) 各装置の仕様詳細は、個別カタログを参照してください。

2) 本装置の測定原理は、株式会社ジェイテクトの特許に基づいています。

標準納期：仕様詳細ご承認後9か月～

3) "レーザーボンドテスター"及び"Laser Bond Tester"は、アイエルテクノロジー株式会社の登録商標です。

販売代理店



株式会社 南陽

福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目19番8号
TEL: 092-473-7711

製造元

iL Technology Corporation

アイエルテクノロジー株式会社

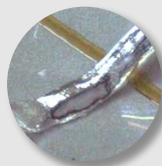
愛知県岡崎市針崎1丁目1番地13

TEL: 0564-73-2005

Products Line-Up for Various Inspection Application

**Industry's
First**

First practical application of non-contact,
non-destructive and instantaneous measurement



■ Laser Bond Tester I d

< Manual >

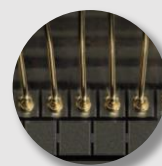
Aluminum Large Diameter Laser Bond Tester
(Measurement target: $\phi 50\mu\text{m} \sim \phi 200\mu\text{m}$
 $\phi 200\mu\text{m} \sim \phi 400\mu\text{m}$)



■ Laser Bond Tester I

< Semi-Auto >

Aluminum Large Diameter Laser Bond Tester
(Measurement target: $\phi 50\mu\text{m} \sim \phi 200\mu\text{m}$
 $\phi 200\mu\text{m} \sim \phi 400\mu\text{m}$)



■ Laser Bond Tester II d

< Manual >

Au/Cu Small Diameter Laser Bond Tester
(Measurement target: $\phi 15\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$)



■ Laser Bond Tester II

< Semi-Auto >

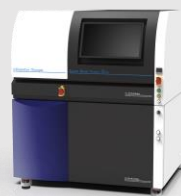
Au/Cu Small Diameter Laser Bond Tester
(Measurement target: $\phi 15\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$)



■ Laser Bond Tester I · II + Magazine Changer

< Full-auto >

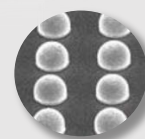
- Au/Cu Small Diameter Laser Bond Tester
(Measurement target: Au/Cu wire : $\phi 15\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$)
- Aluminum Large Diameter Laser Bond Tester
(Measurement target: $\phi 50\mu\text{m} \sim \phi 200\mu\text{m}$, $\phi 200\mu\text{m} \sim \phi 400\mu\text{m}$)



■ Laser Bump Tester

< Manual, Semi-Auto >

Au Bump Laser Bump Tester
(Measurement target:
Au Bump : $\phi 10\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$)



Inspection Target	Aluminum wire bond inner connectivity		Au/Cu wire bond inner connectivity	Au bump inner connectivity
Inspection Product	Power Semiconductor, IGBT		Memory IC, Logic IC Optical Semiconductor	Wafer Level CSP
Wire Dia. Bump Dia.	$\phi 50\mu\text{m} \sim \phi 200\mu\text{m}$ (Small Dia.)	$\phi 200\mu\text{m} \sim \phi 400\mu\text{m}$ (Large Dia.)	$\phi 15\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$ (Ext. Small Dia.)	$\phi 10\mu\text{m} \sim \phi 40\mu\text{m}$ (WL CSP)
Laser type	Infrared Semiconductor Laser		Blue Semiconductor Laser	
Laser Spot Size	$\phi 50\mu\text{m}$	$\phi 200\mu\text{m}$	$\phi 20\mu\text{m}$	$\phi 10\mu\text{m}$
Laser Spot Size	Laser Bond Tester I d -SD50M (Motorized Stage)	Laser Bond Tester I d -LD200M	Laser Bond Tester II d -ESD20M	Laser Bump Tester -WB10M
Semi-Automatic Inspection System	Laser Bond Tester I -SD50SA (Motorized Stage : MS)	Laser Bond Tester I -LD200SA (MS)	Laser Bond Tester II -ESD20SA (MS)	Laser Bump Tester -WB10SA (MS)
Full Automatic Inspection System	Laser Bond Tester I -SD50A (+Magazine Changer : +MC)	Laser Bond Tester I -LD200A (+MC)	Laser Bond Tester II -ESD20A (+MC)	Laser Bump Tester -WB10A (+MC)
In-Line Full- Auto System	Coming Soon	Coming Soon	Coming Soon	Coming Soon

Standard delivery time : 6 months or more after detailed specification approval

As of January 2023

Standard delivery time : 9 months or more after detailed specification approval.

- 1) Refer to the individual catalogs for detailed specifications of each system.
- 2) The measurement principle of this system is based on JTEKT Corporation patent.
- 3) “レーザーボンドテスター” and “Laser Bond Tester” It is a registered trademark of iL Technology Corporation.

Sales Distributor



NANYO CORPORATION

Address : 3-19-8, Hakataekimae, Hakata-ku, , Fukuoka
TEL : +81(0)92-473-7711

Manufacturer

iL Technology Corporation

Address : 1-13, 1-chome, Harisaki, Okazaki-shi, Aichi
TEL : +81(0)564-73-2005